

2021.10.04 新製品リリース

## 高歩留り・高スループットを実現した 「ウエハ対応はんだボールマウンタ」 の販売開始のお知らせ

AIメカテック株式会社(本社：茨城県龍ケ崎市向陽台、社長：阿部 猪佐雄)は、半導体事業の新たな提案として、新製品「ウエハ対応はんだボールマウンタ」の販売を開始します。

本装置は、半導体パッケージ用基板向けに長年培ったはんだボール搭載技術をウエハに適応し、高歩留りを実現しました。さらに、ウエハ対応 高スループット 新型ヘッドを搭載することで、量産における生産性と材料使用効率を大幅に改善しました。本装置とウエハ対応検査リペア装置とのシステム化によりトータルソリューションとして提案してまいります。

モバイル機器などで数多く採用されている先進半導体パッケージのFOWLP、WLCSPなどは、ウエハ全面に対するはんだボール搭載プロセスが採用されています。本プロセスは、ウエハ切断プロセス後のボール実装と比較し、生産性向上に大きく寄与しています。現在、更なる高歩留り・高スループット化が求められており、本装置の採用が検討されています。

弊社は、これからも製造プロセスのイノベーションを通して安全で住みよい社会の発展に貢献できる企業を目指して参ります。

### お問い合わせ

AIメカテック株式会社

営業部 TEL:0297-62-9119

<https://www.ai-mech.com/newproducts/>



ウエハ対応はんだボールマウンタ装置(外観)